

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第3648699号
(P3648699)

(45) 発行日 平成17年5月18日(2005.5.18)

(24) 登録日 平成17年2月25日(2005.2.25)

(51) Int.Cl.⁷

H01L 21/66

F I

H01L 21/66

B

請求項の数 8 (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願平9-34368	(73) 特許権者	000219967
(22) 出願日	平成9年2月3日(1997.2.3)		東京エレクトロン株式会社
(65) 公開番号	特開平10-223704		東京都港区赤坂五丁目3番6号
(43) 公開日	平成10年8月21日(1998.8.21)	(74) 代理人	100096910
審査請求日	平成16年1月20日(2004.1.20)		弁理士 小原 肇
		(72) 発明者	飯野 伸治
			山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の 1 東京エレクトロン山梨株式会社内
		審査官	橋本 憲一郎
		(56) 参考文献	特開平08-005666(JP, A)
		(58) 調査した分野(Int.Cl. ⁷ , DB名)	H01L 21/66

(54) 【発明の名称】 ウエハの一括検査装置及びウエハの一括検査方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

リング状部材と、このリング状部材の内周縁に位置し且つ半導体ウエハの全ての電極に一括して電氣的に接触する端子を有するコンタクトと、上記リング状部材上に設けられ且つ上記半導体ウエハを支持するリング状の弾性部材と、この弾性部材、上記半導体ウエハ及び上記コンタクトで囲まれた空間内の圧力を減圧する排気手段とを備えたことを特徴とするウエハの一括検査装置。

【請求項2】

半導体ウエハと対向するように設けられ且つ上記半導体ウエハの電極と接触する突起端子を有するコンタクトと、上記半導体ウエハと接触して上記半導体ウエハと上記コンタクトとの間を密閉空間として形成するリング状の弾性部材と、上記密閉空間と連通するように設けられ且つ上記密閉空間内の圧力を減圧して上記半導体ウエハの各電極と上記コンタクトの各突起端子とを電氣的に接続させるための排気路とを備えたことを特徴とするウエハの一括検査装置。

【請求項3】

半導体ウエハを吸着保持して搬送するアームと、このアームを介して半導体ウエハを搬出入する搬出入口を有し且つ密閉及び移動可能なチャンバーと、このチャンバーの下部に設けられたリング状の位置調整機構と、この位置調整機構によってX、Y、Z及び 方向に移動可能に保持され且つ上記半導体ウエハの全ての電極に一括して電氣的に接触する突起端子を内面に有するコンタクトと、このコンタクトの外周に沿って上記位置調整機構上

10

20

に設けられ且つ上記半導体ウエハを支持するリング状の弾性部材と、この弾性部材、上記半導体ウエハ及び上記コンタクタで囲まれた空間内の圧力を減圧する排気手段と、この排気手段により減圧されて上記各電極と上記各突起端子とが一括接触した状態で上記コンタクタ外面の接続端子と電氣的に導通するテストヘッドとを備えたことを特徴とするウエハの一括検査装置。

【請求項 4】

上記チャンバーは上記半導体ウエハを検査温度に調整するためのガスを給排するガス給排部を有することを特徴とする請求項 3 に記載のウエハの一括検査装置。

【請求項 5】

上記位置調整機構は上記コンタクタを X、Y、Z 及び 方向へそれぞれ独立して移動させる圧電素子を有することを特徴とする請求項 3 または請求項 4 に記載のウエハの一括検査装置。

10

【請求項 6】

上記テストヘッド上に接続リングを設け、この接続リングを介して上記コンタクタと上記テストヘッドとを電氣的に接続することを特徴とする請求項 3 ～ 請求項 5 のいずれか 1 項に記載のウエハの一括検査装置。

【請求項 7】

上記接続リングはマルチプレクサを内蔵することを特徴とする請求項 6 に記載のウエハの一括検査装置。

【請求項 8】

20

コンタクタ表面に半導体ウエハの多数の電極に対応して形成された各突起端子を上記半導体ウエハの各電極に一括して電氣的に接触させて上記半導体ウエハの電氣的特性検査を行う方法において、上記半導体ウエハをアームを介して保持した状態で上記コンタクタを下端部に有するチャンバー内に搬入し、上記半導体ウエハと上記コンタクタ間に弾性部材を介して密閉空間を作り、上記半導体ウエハの各電極と上記コンタクタの各突起端子を位置合わせした後、上記密閉空間内の圧力を減圧することにより上記弾性部材を圧縮変形させて上記各電極と上記各突起端子とを接触させ、次いで、上記チャンバーをテストヘッド上へ移動させて上記コンタクタと上記テストヘッドとを導通可能にすることを特徴とするウエハの一括検査方法。

【発明の詳細な説明】

30

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体ウエハ（以下、単に「ウエハ」と称す。）とコンタクタとを一括して接触させてウエハの電氣的特性検査を行うウエハの一括検査装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

半導体ウエハの電氣的検査を行う検査装置として例えばプローブ装置が広く知られている。このプローブ装置は、一般に、ウエハを 1 枚ずつ搬送するウエハ搬送機構と、このウエハ搬送機構で搬送する間に例えばオリエンテーションフラットを基準にしてウエハのプリアライメントを行うサブチャックと、このサブチャック上でプリアライメントされたウエハを搬送機構を介して受け取る X、Y、Z 及び 方向に移動可能なメインチャックと、このメインチャック上方に配置されたプローブカードと、このプローブカードとテストとの電氣的接続を図る接続リング及びテストヘッドと備えて構成されている。

40

【0003】

そして、ウエハの電氣的特性検査を行う場合に、図 7 に示すように、ウエハ W を載せたメインチャック 1 を X、Y、Z 及び 方向に移動させてウエハの電極パッドとプローブカード 2 のプローブ針 3 との位置合わせを行った後、メインチャックを Z 方向に移動させてウエハの電極とプローブ針 3 とを電氣的に接触させてウエハの電氣的特性検査を行うようにしてある。

【0004】

50

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、最近、ウエハが大口径化し、例えば12インチウエハになると、従来の6インチあるいは8インチウエハと比較してメインチャック自体が大型化するばかりでなく、メインチャックのX、Y方向の移動領域が格段に広くなり、検査装置が大型化するという課題があった。また、12インチのウエハは6インチあるいは8インチのウエハと比較して1枚のウエハに形成されるチップの数が激増し、1チップ毎あるいは複数個のチップ毎にメインチャックを繰り返し移動させて電極パッドとプローブ針と接触させていたのではウエハの検査に多大に時間を要するという課題があった。また、ウエハ内の高低温条件の均熱化及び昇降温の迅速化が求められている。

【0005】

尚、検査時間を短縮する技術として例えば特開昭61-78136号公報や特開昭64-39559号公報においてウエハの全ての電極パッドに対して一括して接触するプローブカードが提案されているが、各プローブカードを適用した一括接触させる検査装置については提案されていない。一方、例えば特開平3-171749号公報には一括して接触させるプローブカードを用いたバーイン用の試験装置が提案されているが、この検査装置の場合にはウエハを載せる載置台や、プローブカードを取り付けるステージ及びその駆動機構を有し、ウエハとプローブカードとを接触させる方式等は依然として従来の方式のままであり、装置の小型化という面では十分なものではない。

【0006】

本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、半導体ウエハの全電極とコンタクタの全端子とを短時間で一括して接触させて検査時間を短縮すると共に、半導体ウエハの載置台を省略して装置の小型化を実現することができるウエハの一括検査装置及びウエハの一括検査方法を提供することができる。

【0007】**【課題を解決するための手段】**

本発明の請求項1に記載のウエハの一括検査装置は、リング状部材と、このリング状部材の内周縁に位置し且つ半導体ウエハの全ての電極に一括して電氣的に接触する端子を有するコンタクタと、上記リング状部材上に設けられ且つ上記半導体ウエハを支持するリング状の弾性部材と、この弾性部材、上記半導体ウエハ及び上記コンタクタで囲まれた空間内の圧力を減圧する排気手段とを備えたことを特徴とするものである。

また、本発明の請求項2に記載のウエハの一括検査装置は、半導体ウエハと対向するように設けられ且つ上記半導体ウエハの電極と接触する突起端子を有するコンタクタと、上記半導体ウエハと接触して上記半導体ウエハと上記コンタクタとの間を密閉空間として形成するリング状の弾性部材と、上記密閉空間と連通するように設けられ且つ上記密閉空間内の圧力を減圧して上記半導体ウエハの各電極と上記コンタクタの各突起端子とを電氣的に接続させるための排気路とを備えたことを特徴とするものである。

また、本発明の請求項3に記載のウエハの一括検査装置は、半導体ウエハを吸着保持して搬送するアームと、このアームを介して半導体ウエハを搬出入する搬出入口を有し且つ密閉及び移動可能なチャンバーと、このチャンバーの下部に設けられたリング状の位置調整機構と、この位置調整機構によってX、Y、Z及び 方向に移動可能に保持され且つ上記半導体ウエハの全ての電極に一括して電氣的に接触する突起端子を内面に有するコンタクタと、このコンタクタの外周に沿って上記位置調整機構上に設けられ且つ上記半導体ウエハを支持するリング状の弾性部材と、この弾性部材、上記半導体ウエハ及び上記コンタクタで囲まれた空間内の圧力を減圧する排気手段と、この排気手段により減圧されて上記各電極と上記各突起端子とが一括接触した状態で上記コンタクタ外面の接続端子と電氣的に導通するテストヘッドとを備えたことを特徴とするものである。

【0008】

また、本発明の請求項4に記載のウエハの一括検査装置は、請求項3に記載の発明において、上記チャンバーは上記半導体ウエハを検査温度に調整するためのガスを給排するガス給排部を有することを特徴とするものである。

10

20

30

40

50

【 0 0 0 9 】

また、本発明の請求項 5 に記載のウエハの一括検査装置は、請求項 3 または請求項 4 に記載の発明において、上記位置調整機構は上記コンタクタを X、Y、Z 及び 方向へそれぞれ独立して移動させる圧電素子を有することを特徴とするものである。

【 0 0 1 0 】

また、本発明の請求項 6 に記載のウエハの一括検査装置は、請求項 3 ～請求項 5 のいずれか 1 項に記載の発明において、上記テストヘッド上に接続リングを設け、この接続リングを介して上記コンタクタと上記テストヘッドとを電氣的に接続することを特徴とするものである。

【 0 0 1 1 】

また、本発明の請求項 7 に記載のウエハの一括検査装置は、請求項 6 に記載の発明において、上記接続リングはマルチプレクサを内蔵することを特徴とするのである。

【 0 0 1 2 】

また、本発明の請求項 8 に記載のウエハの一括検査方法は、コンタクタ表面に半導体ウエハの多数の電極に対応して形成された各突起端子を上記半導体ウエハの各電極に一括して電氣的に接触させて上記半導体ウエハの電氣的特性検査を行う方法において、上記半導体ウエハをアームを介して保持した状態で上記コンタクタを下端部に有するチャンバー内に搬入し、上記半導体ウエハと上記コンタクタ間に弾性部材を介して密閉空間を作り、上記半導体ウエハの各電極と上記コンタクタの各突起端子を位置合わせした後、この密閉空間内の圧力を減圧することにより上記弾性部材を圧縮変形させて上記各電極と上記各突起 20
端子とを接触させ、次いで、上記チャンバーをテストヘッド上へ移動させて上記コンタクタと上記テストヘッドとを導通可能にすることを特徴とするものである。

【 0 0 1 3 】

【発明の実施の形態】

以下、図 1 ～図 6 に示す実施形態に基づいて本発明を説明する。

本実施形態の検査装置 10 は、例えば図 1 に示すように、表面全面に多数個の IC チップが形成されたウエハ W を真空吸着して搬送する多関節型の搬送ロボット（図示せず）のアーム 11 と、このアーム 11 がウエハ W を保持した状態で侵入できるチャンバー 12 とを備えている。このチャンバー 12 は、下端が開口し、上端が閉止したほぼ円筒状に形成され、しかも後述するテストヘッドに対して昇降可能になっている。そして、チャンバー 12 の周壁の一部にはウエハ W をアーム 11 を介して搬出入する搬出入口 12 A が形成され、搬出入口 12 A はゲートバルブ 12 B によって開閉可能になっている。このゲートバルブ 12 B は図 1 に示すようにアーム 11 がチャンバー 12 内に侵入した状態で搬出入口 12 A を閉じ、チャンバー 12 内の気密を保持できるようにしてある。また、チャンバー 12 の上壁にはガス供給管が接続されたガス供給口 12 C と、ガス排出管が接続されたガス排出口 12 D が形成され、ガス供給口 12 C を介してウエハ W の温度を調節する冷却用または加熱用のガスをチャンバー 12 内へ供給してチャンバー 12 内の温度を制御し、冷却後あるいは加熱後のガスをガス排出口 12 D から排出するようにしてある。また、チャンバー 12 の下端には径方向内方へ延びるフランジ 12 E が形成されている。

【 0 0 1 4 】

上記チャンバー 12 のフランジ 12 E にはリング状に形成された後述の位置調整機構 13 が設けられている。この位置調整機構 13 の内周上端には例えばポリイミド系樹脂等の透明樹脂によって形成されメンブレンカードからなるコンタクタ 14 が保持され、このコンタクタ 14 によってチャンバー 12 の下端開口を閉塞している。コンタクタ 14 の内面にはウエハ W の全 IC チップに形成された例えば 2 ～ 3 万個の電極パッドにそれぞれ対応する突起端子 14 A（図 1 では上向きの矢印で示してある）が形成され、その外面には各突起端子に対応した接続端子が 2 ～ 3 万個形成されている。また、位置調整機構 13 上面には O リング 15 が設けられ、この O リング 15 上にアーム 11 で搬入したウエハ W の表面を接触させて電極パッドを下向きに載置するようにしてある。従って、アーム 11 がウエハ W を保持した状態でチャンバー 12 内に侵入し、ウエハ W の表面を O リング 15 に接触 50

させると、Ｏリング１５を介してコンタクタ１４とウエハＷの間に密閉空間（図１では斜線で示してある）１６を形成するようにしてある。

【００１５】

また、上記検査装置１０は、図１に示すように、コンタクタ１４の外面に形成された２～３万個の接続端子とそれぞれ電氣的に接触する同数の接続端子例えばポゴピン（図１では３個の矢印で示してある）１７Ａを上面に有する接続リング１７と、この接続リング１７の下面にポゴピン１７Ａより少ない接続端子とそれぞれ電氣的に接触する接続端子例えばポゴピン（図１では３個の三角突起として示してある）１８Ａを上面に有するテストヘッド１８とを備えている。そして、接続リング１７及びテストヘッド１８はチャンバー１２の真下にこれと同軸状態で配置されている。このテストヘッド１８はピンエレクトロニクスを内蔵していることからコンタクタ１４の２～３万個の接続端子に対して同時に接続をとることができないため（全電極パッドとの接続をとるためには極めて多くの電子部品が必要となり、それ故、テストヘッドが極めて大きく、しかも重量的にも極めて重くなって現実的でない）、テストヘッド１８のポゴピン１８Ａの本数は例えば接続リング１７のポゴピン１７Ａの本数の十分の一程度に過ぎない。そのため、接続リング１７内にはマルチプレクサが内蔵され、このマルチプレクサによりコンタクタ１４とテストヘッド１８との接続を逐次切り替えるようにしてある。従って、検査時には、チャンバー１２が下降してコンタクタ１４と接続リング１７とが電氣的に接続され、テストヘッド１８を介してウエハＷと図示しないテストとの間で測定用信号を遣取りするようにしてある。

【００１６】

また、図２に示すように位置調整機構１３の一部に排気路１９が形成され、この排気路１９の一端はＯリング１５の内側で開口し、他端がＯリング１５の外側で開口している。また、チャンバー１２の側壁には排気路１９の近傍に位置させた排気路１９Ａが形成され、これらの両排気路１９、１９Ａは例えばフレキシブル配管２０を介して連通している。更に、チャンバー１２を貫通する排気路１９Ａには図示しない配管を介して排気手段としての真空ポンプが接続され、真空ポンプにより密閉空間１６の圧力を減圧し、この時のＯリング１５の圧縮変形でウエハＷの全電極パッドとこれらに対応するコンタクタ１４の全突起端子とが一括して電氣的に接触するようにしてある。

【００１７】

ところで、上記位置調整機構１３は、図３の（ａ）、（ｂ）に示すように、上下３段の第１、第２、第３リング１３Ａ、１３Ｂ、１３Ｃと、第１、第２リング１３Ａ、１３Ｂ間、第２、第３リング１３Ｂ、１３Ｃ間及び第３リング１３Ｃ、フランジ１２Ｅ間にそれぞれ介装されたＸ方向、Ｙ方向、方向のガイドレール１３Ｄ、１３Ｅ、１３Ｆと、これらのガイドレール１３Ｄ、１３Ｅ、１３Ｆに従って上記各リング１３Ａ、１３Ｂ、１３Ｃを僅かな距離だけ往復移動させる第１、第２、第３圧電素子１３Ｇ、１３Ｈ、１３Ｉとを備えている。即ち、第１リング１３Ａには第１圧電素子１３Ｇが固定され、この第１圧電素子１３Ｇに電圧が印加されると僅かな歪を生じ、この歪により第１リング１３ＡがＸ方向ガイドレール１３Ｄを介して例えば０．１～０．２ｍｍ移動し、コンタクタ１４のＸ方向の位置調整を行うようにしてある。また、第２リング１３Ｂには第２圧電素子１３Ｈが固定され、この第２圧電素子１３Ｈを駆動源として第２リング１３ＢがＹ方向ガイドレール１３Ｅに従って０．１～０．２ｍｍ移動してコンタクタ１４のＹ方向の位置調整を行い、第３リング１３Ｃには第３圧電素子１３Ｉが固定され、この第３圧電素子１３Ｉを駆動源として第３リング１３Ｃが方向ガイドレール１３Ｆに従って０．０３°程度正逆方向へ回転移動してコンタクタ１４の方向の位置調整を行うようにしてある。

【００１８】

更に、上記位置調整機構１３を用いてコンタクタ１４の突起端子１４ＡとウエハＷの電極パッドの位置合わせを行う時には例えば図４に示すようにＣＣＤカメラ等からなるアライメント機構２１が用いられる。このアライメント機構２１により透明なコンタクタ１４を通して突出端子１４ＡとウエハＷの電極パッドのＸ、Ｙ座標値を読み取り、両者間の位置ずれ量に基づいて位置調整機構１３の第１、第２、第３圧電素子１３Ｇ、１３Ｈ、１３Ｉ

10

20

30

40

50

に対する印加電圧を調節し、両者をアライメントを行うようにしてある。このアライメントは図4に示すようにチャンバー12がテストヘッド18の上方に離隔した位置で行うようにしてある。また、電極パッドPに図5に示すように窪みRが設けられたウエハWであれば、位置調整機構を不要とするか、あるいはアライメント機構21及び位置調整機構13を用いた位置合わせが多少粗くてもコンタクタ14の突出突起14Aが窪みRに案内されて確実な位置合わせを行うことができる。

【0019】

次に、上記検査装置10を用いた本発明のウエハの一括検査方法の一実施態様について説明する。まず、アーム11でウエハWを真空吸着した後、アーム11を伸ばしてチャンバー12内にウエハWを水平に搬入し、ウエハWの中心とコンタクタ14の中心が一致する位置でアーム11が停止してウエハW、コンタクタ14及びOリング15とで密閉空間を作る。次いで、アーム11が下がりウエハWがOリング15と接触した位置で停止し、ゲートバルブ12Bを閉じてチャンバー12を密閉する。チャンバー12を密閉した状態でチャンバー12内に冷却用または加熱用のガスをガス供給口12Cから供給すると共にガス排出口12Dから冷却用または加熱用のガスを排出しながらウエハWを所定の冷却温度または加熱温度に設定する。尚、アーム11でウエハWをチャンバー12内に搬入する前に、ウエハWの向きを予め設定しておく。

【0020】

次いで、アライメント機構21によってウエハWの電極パッド及びこれに対応するコンタクタ14の突出端子14AのX、Y座標を読み取り、両者間の位置ずれ量を図示しない中央演算処理装置により求め、この位置ずれ量に基づいて位置調整機構13の第1、第2、第3圧電素子13G、13H、13Iに電圧を印加し、コンタクタ14がX、Y、及び方向に移動してコンタクタ14の突出端子14AとウエハWの対応する電極パッドとの位置合わせを行う。その後、図示しない真空ポンプが駆動すると、位置調整機構13の排気路19、フレキシブル配管20及びチャンバー12の排気路19Aを介して密閉空間16内の空気が排気されて減圧状態になってOリング15が圧縮変形し、ウエハWとコンタクタ14が互いに接近し、ウエハWの全電極パッドとコンタクタ14の全突出端子14Aとが接触し両者間で導通可能になる。

【0021】

次いで、チャンバー12が下降し、コンタクタ14の全接続端子と接続リング17の全ボゴピン17Aとが接触し、接続リング17及びテストヘッド18を介して図示しないテストとコンタクタ14、ひいてはウエハWとの間で導通可能な状態になる。この状態でテストから測定用信号を送信すると、ウエハWの電気的特性検査を行うことができる。測定用信号を送信する時には、接続リング17のマルチプレクサによりウエハWの検査領域毎に接続を複数回切り替えてウエハWの電気的特性検査を行う。検査終了後、チャンバー12が上昇して接続リング17から切り離され、チャンバー12が上昇端位置で停止すると、ゲートバルブ12Bが開き、アーム11がチャンバー12内から退出しウエハWを搬出する。その後、同様の手順で他のウエハWについて検査を行う。

【0022】

以上説明したように本実施形態によれば、アーム11を介してチャンバー12内にウエハWを搬入し、このウエハWとコンタクタ14とがOリング15を介して接触した後、両者間の密閉空間16内を減圧状態にすると、ウエハWとコンタクタ14とが一括して電気的に接触するため、検査時間を格段に短縮することができ、しかもウエハW用のメインチャックが不要になると共にメインチャックの水平移動領域が不要になり、装置本体の設置スペースを格段に削減することができる。

【0023】

また、チャンバー12にガス給排口12C、12Dを設け、冷却用ガスまたは加熱用ガスを連続的にチャンバー12内へ供給してウエハWを所定の温度に設定することができるため、低温から高温に至る広い温度範囲でウエハWの検査を行うことができる。また、位置調整機構13がコンタクタ14をX、Y及び方向へ微移動させる第1、第2、第3圧電

10

20

30

40

50

素子 13 G、13 H、13 I を有するため、位置調整機構 13 を格段にコンパクト化することができる。更に、テストヘッド 18 上に接続リング 17 を設け、この接続リング 17 を介してコンタクタ 14 とテストヘッド 18 とを電氣的に接続するようにしたため、テストヘッド 18 の支持機構を削減することができ、装置を更にコンパクト化することができる。また、接続リング 17 はマルチプレクサを内蔵するため、ウエハ W とコンタクタ 14 とを一括して接触させてもウエハ W を確実に且つ正確に検査することができる。

【0024】

図 6 は他の実施形態の検査装置を示す図である。本実施形態の検査装置は上記実施形態のものに準じて構成されているため、各構成要素には上記実施形態の場合と同一の符号を附し、本実施形態の特徴のみについて説明する。本実施形態の検査装置 10 A は、同図に示すように、チャンバー 12 が回転移動すると共に昇降移動するように構成され、しかも接続リング 17 の高さが低く形成されている。更に、アライメント機構 21 がチャンバー 12 の側方に設けられ、同図に示すようにチャンバー 12 を接続リング 17 から切り離し、ほぼ垂直に立てた状態でウエハ W とコンタクタ 14 とを位置合わせするようにしてある。このように接続リング 17 は高さが低く上記実施形態のものと比較して配線が短いため、ウエハ W を高速で検査することができる。また、チャンバー 12 の側方に設けたため、アライメント機構 21 の支持構造を簡素化することができる。その他、本実施形態では上記実施形態と同様の作用効果を期することができる。

【0025】

上記各実施形態では、マルチプレックスを内蔵した接続リング 17 を用いた場合について説明したが、ウエハ W の各 IC チップがセルフチャック回路を備えたものであれば、検査用の電極パッド数を格段に削減することができ、接続リングにマルチプレックスを設けることなく、ポゴピンの本数をテストヘッドのポゴピンの本数に合わせることができ、接続リングを簡素化することができる。

【0026】

尚、上記各実施形態ではコンタクタ 14 を透明樹脂からなるメンブレンによって形成したものであるについて説明したが、メンブレンに代えて透明なガラス基板等の剛性の高いものを用いることができる。コンタクタをガラス基板等によって形成することにより今後ウエハの口径が大きく、その厚みが薄くなった場合に、ウエハとコンタクタ間を減圧すると、ウエハがコンタクタに変形してなじみ、それぞれの電極パッドと突出端子の接触を図ることができる。

【0027】

【発明の効果】

本発明の請求項 1 ～ 請求項 8 に記載の発明によれば、半導体ウエハの全電極とコンタクタの全端子とを短時間で一括して接触させて検査時間を短縮すると共に、半導体ウエハの載置台を省略して装置の小型化を実現することができるウエハの一括検査装置及びウエハの一括検査方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の検査装置の一実施形態のチャンバー部分を破断して示す全体の側面図である。

【図 2】図 1 に示す検査装置の排気手段を拡大して示す断面図である。

【図 3】(a) はコンタクタ及び位置調整機構の関係を示す上からの平面図、(b) はその側面図である。

【図 4】図 1 に示す検査装置におけるウエハとコンタクタとのアライメント動作を示す図 1 に相当する図である。

【図 5】ウエハの電極パッドとコンタクタの突出端子とが接触した状態を拡大して示す模式図である。

【図 6】本発明の他の実施形態を示す図 1 に相当する全体側面図である。

【図 7】従来の検査装置のウエハとコンタクタ（プローブカード）とのアライメント動作を説明するための図である。

10

20

30

40

50

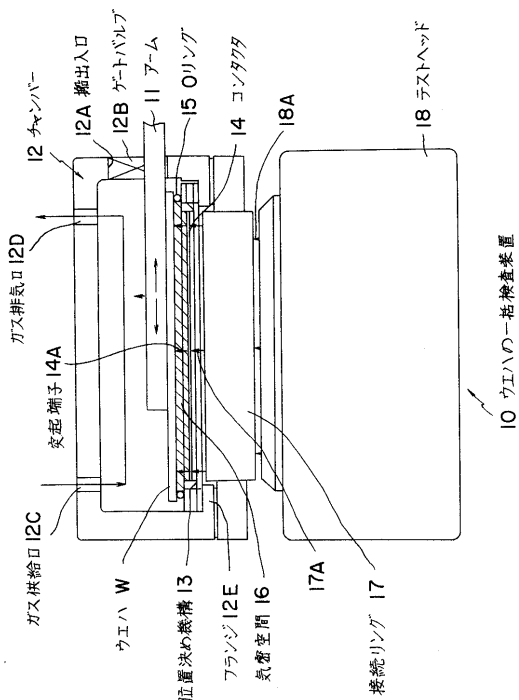
【符号の説明】

- 10 ウエハの一括検査装置
 11 アーム
 12 チャンバー
 12A 搬出入口
 12B ゲートバルブ
 12C ガス供給口（ガス供給部）
 12D ガス排出口（ガス排出部）
 13 位置調整機構
 13G 第1圧電素子
 13H 第2圧電素子
 13I 第3圧電素子
 14 コンタクタ
 14A 突出端子
 15 Oリング（弾性部材）
 16 密閉空間
 17 接続リング
 17A ポゴピン
 18A ポゴピン
 18 テストヘッド

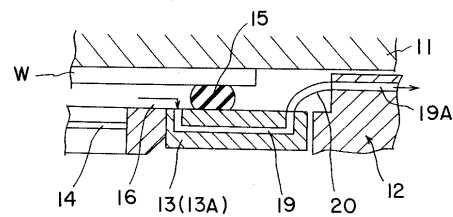
10

20

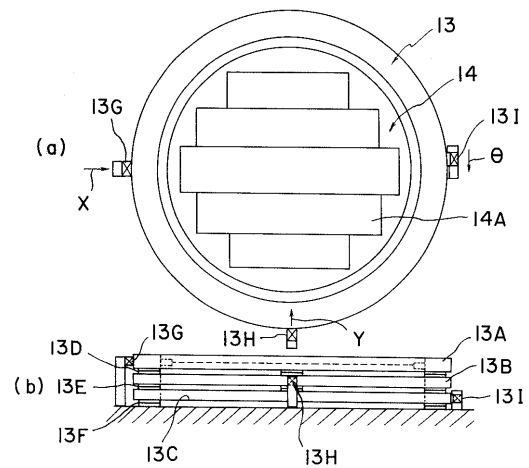
【図1】



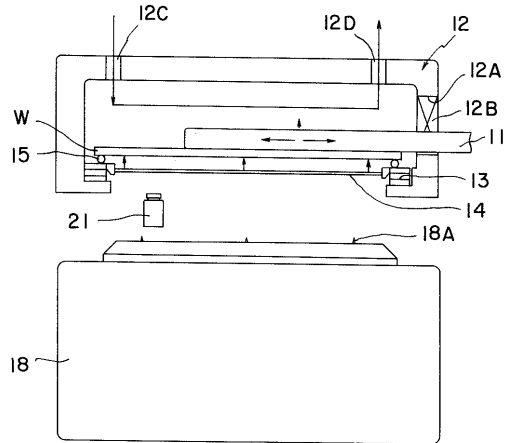
【図2】



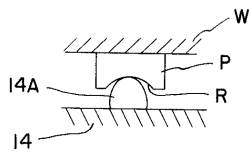
【図3】



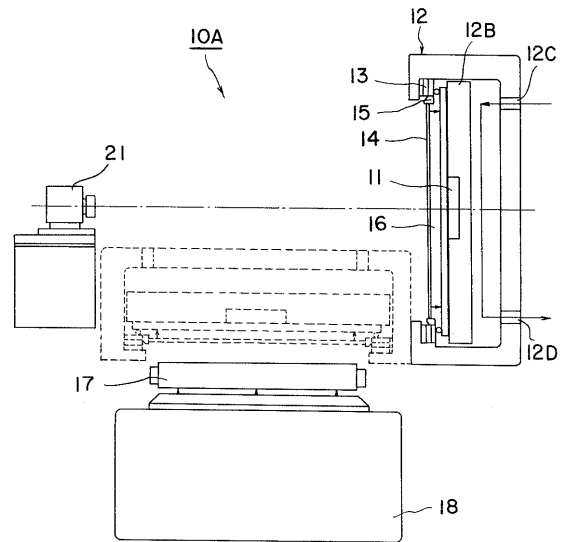
【図 4】



【図 5】



【図 6】



【図 7】

